2017中日电子电路秋季大会暨秋季国际PCB技术/信息论坛日程

时间：2017年10月19-20日
地点：东莞会展国际大酒店

10月19日

时间 / 场次	四楼国际宴会厅 论坛开幕特邀演讲
13:00-13:15	论坛开幕式 领导致辞
13:15-14:15	《日本政府对于IoT的应用和JPCA的作用》 小岛 正紀•JPCA理事、日本尼关工业株式会社 代表取缔役社长
14:15-15:00	《创新，新的救世主》 王保江•深圳北航新兴产业研究院 执行院长
15:00-15:20	《FISCHER—让测量变得简单》 徐家骥•菲希尔测试仪器有限公司 销售部经理
15:20-15:40	《智能制造浪潮与本质》 赵明辉•广东正业科技股份有限公司 智能装备产品部副总经理
15:40-16:20	《移动机器人技术助力PCB行业智能制造》 吴尧•杭州海康机器人技术有限公司 市场营销部总经理
16:20-17:00	可靠性专题演讲 1-《PWB可靠性的重要性及供应链评估新要求》 李明旺•UL PWB全球专案经理/台湾线路板协会协会白皮书撰写委员/TPCA市场讯息与国际事务委员 2-《车用电路板技术需求及车载基板对应新技术需求及未来发展趋势》 江银辉•广东生益科技股份有限公司 高级工程师
17:00-17:15	赠送冠名单位礼品
17:15-20:00	参观广东正业科技股份有限公司及招待晚宴 （凭券入场）

10月20日

时间 / 场次	四楼5号会议室 印制电路设计与机械加工	四楼7号会议室 图形形成与表面涂覆及检测	四楼8号会议室 挠性和刚挠印制板技术	四楼1号会议室 “前沿材料，助力产业升级”专题演讲 （免费）	四楼3号会议室 “智能制造自动化设备新技术”专题演讲（免费）	四楼9号会议室
09:30-09:55	*A-022* 高速PCB损耗性能的影响分析 程柳军•广州兴森快捷电路科技有限公司	*A-048* 自动曝光机曝光成像不良分析及改善 欧阳诱•生益电子股份有限公司	*A-024* 挠性印制电路板通孔电镀铜抑制剂和电镀配方的研究及应用 王翀•电子科技大学	9:30-9:40 三和国际FTC高频高速方案包价值呈现 刘冬红•三和国际 9:40-10:10 柔性高频高速LCP基板之应用 吕俊逸•台湾佳胜铜箔 10:10-10:30 东洋高频屏蔽膜解决方案 10:30-10:50 绿固高性能软板油墨 柳国富•台湾绿固 10:50-11:00 三和国际高端汽车板方案包价值呈现 刘冬红•三和国际 11:00-11:20 积水高反射率UV阻焊白油墨 吴男•日本积水 11:20-11:40 喷印技术在PCB行业发展的现状和机遇 曹景明•爱克发 11:40-12:00 爱克发黑非林解决方案	9:30-9:45 丝杠系统传动误差的测量与补偿 李红利•广东正业科技股份有限公司 9:45-10:00 环氧基PCB二维码UV激光雕刻工艺研究 肖磊•广东正业科技股份有限公司 10:00-10:15 DNC监控系统在数控钻孔机中的应用研究 陈振康•深圳市大族数控科技有限公司 10:15-10:30 智能化浪潮中LDI对PCB行业的变革 张红日•深圳市大族数控科技有限公司 10:30-11:00 PCB电性能测试技术发展与应用 梁大伟•深圳市东方宇之光科技股份有限公司 11:00-11:30 PCB行业的未来已来—智能工厂 党振，赵凤娟•上海 飞为自动化系统有限公司 11:30-12:00 业界首推的对磨刷板机研磨后板子的涨缩系数测量 陈翠•珠海镇东有限公司	中日企业交流会（凭邀请函）
09:55-10:20	*A-057* 高速PCB设计及制造过程中插入损耗影响规律研究 彭镜辉•广合科技（广州）有限公司	*A-085* 提升50μm/50μm细密线路制作良率的研究 陆玉婷•深圳市景旺电子股份有限公司	*A-032* CO_2 激光加工刚挠结合板盲孔的工艺技术研究 孟佳•台山市精诚达电路有限公司			
10:20-10:45	*A-047* 半固化片对PCB翘曲影响因素研究 王洪府•生益电子股份有限公司	*A-034* 低温条件下化学镀镍的研究 陈苑明•电子科技大学	*A-033* 有机导电膜孔金属化工艺在挠性电路板中的应用研究 罩海浪•台山市精诚达电路有限公司			
10:45-11:10	*A-064* 基板层间对位能力提升研究 唐昌胜•深南电路股份有限公司	*A-068* 银浆贯孔印制电路板OSP涂布后银面异常的解决 赵明宇•广东东硕科技有限公司	*A-043* 一种基于无颗粒导电墨水的手写电子技术在挠性可拉伸电路中的应用 林均秀•珠海元盛电子科技股份有限公司			
11:10-11:35	*A-087* CNC快速换料效率提升改善方法研讨 叶汉雄•惠州中京电子科技有限公司	*A-056* 波峰焊通孔填充不良失效分析 谢世威•广合科技（广州）有限公司	*A-079* HDI刚挠结合板揭盖区域可靠性提升研究 张霞•深圳市景旺电子股份有限公司			
11:35-12:00	*A-099* PCB钻孔用复合垫板的差异化研究 杨迪•深圳市柳鑫实业股份有限公司	*A-074* 外层非欠蚀短路原因分析及改善 赵宇•天津普林电路股份有限公司	*A-093* 高多层不同板厚刚挠结合板制程研究 乐小东•深圳市易迅达电子科技有限责任公司			
12:00-13:30	*午餐（凭餐券）*					
时间 / 场次	四楼5号会议室 特种印制板制造技术	四楼7号会议室 孔金属化和电镀	四楼8号会议室 HDI板技术与经营管理	四楼1号会议室 “前沿材料，助力产业升级”专题演讲 （免费）		
13:30-13:55	*A-012* 埋磁芯PCB生产工艺研究 赵波•胜宏科技（惠州）股份有限公司	*A-016* 黑孔粒径测试影响因素研究 黄扬扬•深圳市贝加电子材料有限公司	*A-004* 改良型半加成法制作精密线路板的研究 唐有军•珠海杰赛科技有限公司	直接丝印法替代部份黄光制程在PCB，FPCB中的运用 何得意•田菱精密制版（深圳）有限公司		
13:55-14:20	*A-029* 挤压螺母PCB制作工艺开发 吴军权•惠州市金百泽电路科技有限公司	*A-011* 微小通孔制作及其填平技术探讨 张龙•胜宏科技（惠州）股份有限公司	*A-027* HDI板通盲孔共镀工艺研究 黄雄•广东东硕科技有限公司	添加剂在填孔电镀中的基理研究与实践探讨 夏海•深圳市板明科技有限公司		
14:20-14:45	*A-044* PTFE板材PCB化学银后毛刺短路引发机理研究 张建•生益电子股份有限公司	*A-042* 含N+杂环基团整平剂对通孔电镀效果的影响研究 郑莉•电子科技大学	*A-041* 高端交换机的发展趋势对PCB的机遇和挑战 曹磊磊•重庆方正高密电子有限公司	微晶磷铜阳极优势：微晶、低磷、省铜、环保 陈中正•佛山市承安铜业有限公司		
14:45-15:10	*A-065* 天线板使用PTFE覆盖膜加工工艺研究 李恒文•深南电路股份有限公司	*A-103* 印制插件氧化问题分析及改善措施 周海光•深圳崇达多层线路板有限公司	*A-078* HDI多层印制板电镀制作技术研究 王波•深圳市景旺电子股份有限公司	中尺寸钻针钻孔过程中的孔粗解决方案 王磊•深圳市金洲精工科技股份有限公司		
15:10-15:35	*A-086* 内嵌氮化铝（AlN）陶瓷绝缘散热模块的PCB板的制作工艺探讨 付凤奇•深圳市景旺电子股份有限公司	*A-023* 激光微孔电镀填孔空洞研究 何泳仪•广州兴森快捷电路科技有限公司	*A-097* 基于GRPS和云技术的工厂设备数据云监控方法研究 陈锐•油头超声印制板公司	无铅喷锡工艺关键点控制 岑磊•广州汉源新材料股份有限公司		
15:35-16:00	*A-098* 高精密电感类PCB板件的加工可靠性研究 林伟娜•油头超声印制板公司	*A-072* 低铜体系脉冲电镀填通孔作用机理研究 柳祖善•广州兴森快捷电路科技有限公司	*A-053* PCB全自动在线二维码激光雕刻系统可靠性研究 李廷春•广东正业科技股份有限公司	5G通讯时代线路板化学品的发展方向及应对方案 张磊•深圳市天熙科技开发有限公司		
16:00-16:25	*A-038* 3D铜柱互连阵列对封装基板热传导的仿真研究 陈苑明•电子科技大学	*A-062* 电镀微小铜粒产生原理探究 曹自强•深南电路股份有限公司	*A-094* Anylayer板靶标创新设计与应用 常选委•博敏电子股份有限公司	LDI光致抗蚀剂的研究与进展 王俊峰•深圳市容大感光科技股份有限公司		
16:25-16:50	*A-059* 印制电路板埋嵌电感化学镀Ni基磁芯材料研究 周国云•电子科技大学	*A-063* 多层电路板凹蚀工艺能力提升研究 曹权根•深南电路股份有限公司	*A-096* 高阶HDI印制电路板共性关键技术研究 陈世金•博敏电子股份有限公司	有机保护涂覆层对通孔波峰焊焊接影响研究 赵明宇，叶绍明，万会勇•广东东硕科技有限公司		
17:15-20:00	会议结束					

10月19日-20日

四楼2号会议室
企业创新技术成果展示
企业创新技术成果展示

★具体演讲安排以论坛会当天为准